**证券代码：688521 证券简称：芯原股份**

**芯原微电子（上海）股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √ 特定对象调研 □ 分析师会议□ 媒体采访 □ 业绩说明会□ 新闻发布会 □ 路演活动□ 现场参观 √ 电话会议□ 其他（ ）  |
| **参与单位名称** | 2025年9月11日Neuberger Berman、碧云资本、长信基金、海富通基金、宏利基金、金鹰基金、诺安基金、太平洋资管、易方达基金、朱雀基金等2025年9月12日博道基金 |
| **时间** | 2025年9月11日、2025年9月12日 |
| **调研方式** | 线上及线下会议 |
| **公司接待人员姓名** | 公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民）公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁：石雯丽 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** |
| **公司介绍** | 芯原是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司拥有自主可控的图形处理器IP（GPU IP）、神经网络处理器IP（NPU IP）、视频处理器IP（VPU IP）、数字信号处理器IP（DSP IP）、图像信号处理器IP（ISP IP）和显示处理器IP（Display Processing IP）这六类处理器IP，以及1,600多个数模混合IP和射频IP。基于自有的IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。为顺应大算力需求所推动的SoC（系统级芯片）向SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口IP、Chiplet芯片架构、先进封装技术、面向AIGC和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司Chiplet技术、项目的研发和产业化。基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。芯原在传统CMOS、先进FinFET和FD-SOI等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有14nm/10nm/7nm/6nm/5nmFinFET和28nm/22nmFD-SOI工艺节点芯片的成功流片经验。此外，根据IPnest在2025年的统计，从半导体IP销售收入角度，芯原是2024年中国大陆排名第一、全球排名第八的半导体IP授权服务提供商；2024年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据IPnest的报告和企业公开数据，在全球排名前十的IP企业中，芯原的IP种类排名前二。随着后续客户产品的逐步量产，公司将进一步提升特许权使用费收入，公司IP授权业务的规模效应将进一步扩大。2025年第二季度，公司实现营业收入5.84亿元，环比增长49.90%，主要由知识产权授权使用费收入及量产业务收入增长所带动。公司潜心投入关键应用领域技术研发，如五年前开始布局Chiplet技术及其在生成式人工智能和智慧驾驶上的应用，并持续开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户。公司在手订单已连续七个季度保持高位，再创公司历史新高，截至2025年第二季度末，公司在手订单金额为30.25亿元，较2025年第一季度末增长5.69亿元，环比增长23.17%。公司技术能力业界领先，并持续获得全球优质客户的认可，2025年第二季度，公司新签订单11.82亿元，单季度环比提升近150%，支撑未来公司收入增长。 |
| **交流问答** | **问题：公司披露并购芯来科技，请问本次并购可以带来哪些协同效应？**回复：公司近期披露了并购芯来科技的预案文件，预计本次交易完成后，芯来科技将成为芯原股份的全资子公司。随着RISC-V生态的逐步成熟，以及芯原股份在RISC-V相关业务上快速发展的需要，公司将通过本次交易，进一步强化在RISC-V领域的布局。目前，公司已拥有针对异构计算的丰富的处理器IP储备，本次交易将为公司补足优质且具有高速发展前景和广阔应用空间的CPU IP，从而构建全栈式异构计算IP平台，进一步提升公司的竞争力、拓展与现有客户的合作深度、提高客户粘性，以及扩大业务发展空间。此外，本次交易使芯原股份能够在为客户定制AI ASIC时，灵活采用通用RISC-V CPU、定制化指令扩展及微架构创新，打造更具差异化和市场竞争力的芯片解决方案。公司还可依托RISC-V开放生态，高效利用现有技术成果，为不同AI应用场景构建更灵活的软硬件设计平台。上述成果将为公司的AI ASIC业务带来更高的效益与产业价值，进一步推动AI ASIC和RISC-V技术的协同发展与产业化。**问题：请问公司新签订单增速较快，主要有受到哪些领域驱动？**回复：今年受到AI算力相关需求带动，公司新签订单增长明显。根据公司《关于新签订单的自愿性披露公告》，2025年7月1日至2025年9月11日，公司新签订单12.05亿元，较去年第三季度全期大幅增长85.88%，新签订单已创历史新高，其中AI算力相关的订单占比约64%。除新签订单创历史新高外，公司在手订单持续保持高位，预计将对公司后续经营业绩产生深远的影响。**问题：请问公司如何看待SerDes IP技术的发展，未来是否有行业整合的规划？**回复：随着数据中心对网络通信速度和性能需求的不断提升，高速接口技术也迎来关键发展时期，这其中最为关键的高速SerDes接口IP已经成为了近年来研究的热点。该接口IP实现了高速串行通信链路的升级，提供更多带宽和更高端口密度，提升数据中心效率，为大数据的持续发展奠定基础。作为半导体IP和一站式芯片定制服务平台的行业龙头，芯原多年以来一直坚持以内部自主研发为主，在自主创新的同时适时对芯原所需的技术和团队进行准确的收购和引进、吸收再创新，在此过程中，芯原的IP得到了充实，芯片定制能力也逐渐变强。未来，公司将继续依托平台化公司的行业理解，积极推进产业生态建设，视业务需要择机进行与公司战略发展方向相一致的投资或并购公司，并将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。**问题：请问公司在RISC-V领域有哪些布局？**回复：公司以推动RISC-V生态发展为切入点，已积极布局RISC-V行业超过7年。2018年7月上海市经信委发布国内首个和RISC-V相关的支持政策。2018年9月，在上海市经信委支持下及上海集成电路行业协会推荐下，公司作为首任理事长单位，牵头成立了中国RISC-V产业联盟（CRVIC）。截至2025年6月底，会员单位已达到204家。由中国RISC-V产业联盟和芯原股份共同主办的滴水湖中国RISC-V产业论坛已经成功召开了4届，每届会议集中发布10余款来自不同本土企业的国产RISC-V芯片新品，现已累计推广了40多款。2024年9月，公司联合芯来科技、达摩院（上海）共同发起成立了民办非企业单位——上海开放处理器产业创新中心（SOPIC）。该中心专注于推动处理器技术，特别是基于开放指令集架构（如RISC-V）的研发、生态建设和产业化应用。2025年7月16-19日，芯原股份协助上海开放处理器产业创新中心在上海举办第五届“RISC-V中国峰会”，包括1场主论坛、9场垂直领域分论坛、5场研习会、11项同期活动，以及4500平方米未来科技展览区；汇聚来自17个国家的数百家企业、研究机构及开源技术社区参会。主论坛当日共计3000余人线下参会，12.5万人次线上观看论坛直播；当日媒体原创报道达200余篇，会后媒体原创报道总数达425篇。参会总人数为8188人，总人次超过万人。目前，公司已与业内多家RISC-V领先企业达成合作。截至2025年6月末，公司的半导体IP已经获得RISC-V主要芯片供应商的10余款芯片所采用，并为20家客户的23款RISC-V芯片提供了一站式芯片定制服务，上述项目正陆续进入量产。同时，芯原股份还基于RISC-V核推出了包含数据中心视频转码、可穿戴健康监测、物联网无线通信、带硬件安全支持的智能传感SoC等多个芯片设计平台，以及基于RISC-V核的硬件开发板，上述解决方案正逐步获得客户采用，有力地推动了RISC-V技术的产业化进程。 |